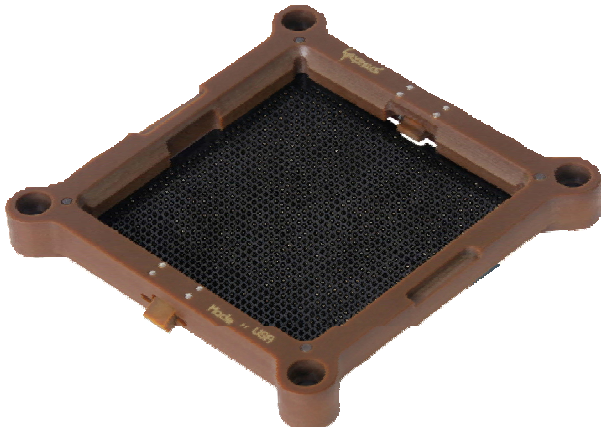
ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

HSIO technologies

BGA65

0.65-1.0 **миллиметровые панельки, обеспечивающие надежное испытание высокочастотных компонентов и систем с высокой повторяемостью результатов**



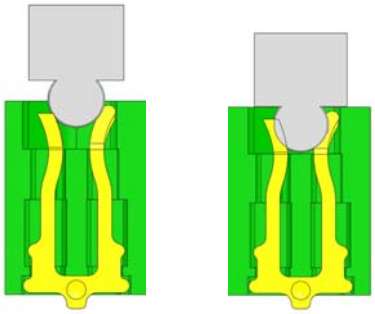
Компания HSIO Technologies разработала испытательные панельки BGA65 в строгом соответствии с требованиями к надежности высококачественного сигнала для испытания высокочастотных компонентов и систем. Эти высококачественные, компактные испытательные панельки удовлетворяют широкому спектру стандартов и размеров корпуса, а также количеству вводов-выводов. Испытание приборов в корпусе BGA при помощи специальных сокетов BGA65 обеспечивает успешное выполнение следующих задач:

- Разработка и определение характеристик
- Разработка и оценка программного обеспечения
- Маркетинг и оценка монтажных схем
- Валидация платформы
- Системное соединение
- Экранирование устройства

ПРЕИМУЩЕСТВА

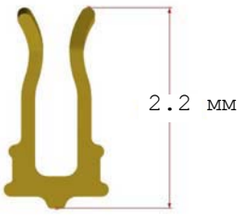
Надежность сигнала	Короткий путь прохождения сигнала способствует снижению коэффициента индукции, обеспечивая надежное электрическое соединение.
Механическая прочность	Действие по протирке-срезанию окисной пленки защищает контакты от образования налета припоя и обеспечивает стабильное сопротивление перехода в паре шариковый вывод - контакт.
Взаимозаменяемость контактных групп	Использование панелек с взаимозаменяемыми контактными группами значительно снижает затраты по сравнению с покупкой нового панелек.
Высокая эффективность по времени	Размещение пассивного компонента возле устройства, интегрированного в стандартный корпус панельки, обеспечивает превосходные электрические характеристики при использовании стандартных конструкций и сокращает время подготовки к технологическому процессу производства.
Универсальность и экономическая эффективность	Испытательные панельки BGA65 спроектированы с учетом существующих требований к надежности, высокому качеству и эффективности для большинства применяемых устройств, платформ и системных применений.

МЕТОДОЛОГИЯ



Тестовая площадка в разрезе

КОНТАКТЫ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сигнальная характеристика	Миниатюрные штампованные контакты типа BeCu обеспечивают сверхкороткий путь прохождения сигнала.
Срезающее-протирочное действие по окислу	Панелька BGA65 имеет острые кромки для прорезывания оксидной пленки на поверхности шарика из припоя.
Контактные группы и контакты	Возможность легкой замены контактных групп , а также отдельных контактов при эксплуатации
Разъединение вблизи устройства	Мелкие шаги сетки наряду с крупными гнездами разрыва, спроектированные для корпусов стандартных размеров, позволяют размещать пассивные компоненты вблизи устройства.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Шаг 1.0 мм

Время задержки	14 пс
Собственная индуктивность	0.63 нГ
Взаимная индуктивность	0.117 нГ
Ёмкость при заземлении	0.319 пФ
Взаимная ёмкость	0.056 пФ
Вносимые потери	-1 дБ 22.1 ГГц
Импеданс	43.5Ω

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

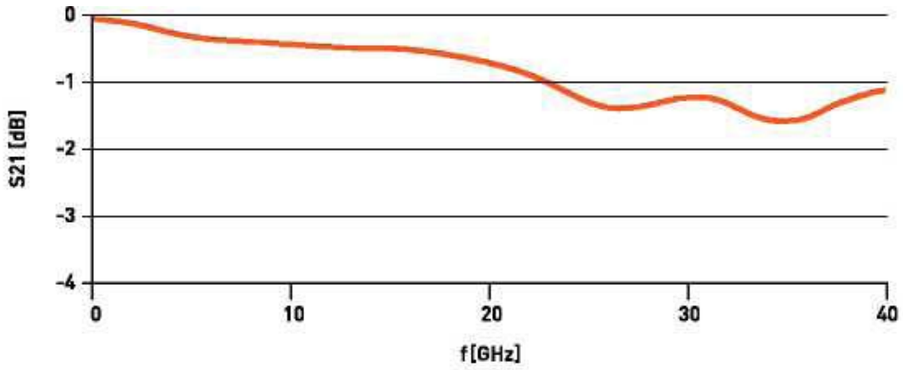
Сила тока	4.0 А (свободный воздух)
Контактное сопротивление	<25 миллиом
Срок службы	30 000-50 000 циклов сопряжения
Нормальное усилие	30-40 грамм/контакт
Вертикальное сжатие	0.15 мм

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал изготовления контакта и покрытие	Медный сплав (Cu) Золото (Au) поверх никеля (Ni)
Высота контакта	2.16 мм
Корпус	Полиимид (Cirlex®) или Torlon® 5030
Каркас	Torlon® 5030, Ultem® 2300 или равноценное
Условия эксплуатации	-40°C - 150°C (-40°F - 302°F)

Технические параметры могут отличаться в зависимости от приложения и требований о соответствии. По запросу возможно предоставление дополнительной информации.

ВНОСИМЫЕ ПОТЕРИ **Шаг 1,0 мм**



©Copyright2012.
HSIO Technologies,LLC/ All right reserved/ Data subject to change without notice HSIO Technologies, LLC/13300 67th Avenue North, Maple Grove, MN 55311 USA. +1.763.447.6260/ Sales@HSIOTech.com/ www.HSIOTech.com

ЗАО «ЭлекТрейд-М»
Россия, 115404, г.Москва,
11-я Радиальная ул., д.2,офис 20
Тел./Факс: +7.499.218.2360 /
info@eltm.ru / www.eltm.ru